

广东辰奕智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐人(主承销商):兴业证券股份有限公司

特别提示

广东辰奕智能科技股份有限公司(以下简称“辰奕智能”或“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2023]1491号)。发行人的股票简称称为“辰奕智能”,股票代码为“301578”。

兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”或“保荐人(主承销商)”)担任本次发行的保荐人(主承销商)。

本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。

发行人与保荐人(主承销商)协商确定本次发行股份数量为1,200.00万股,本次发行价格为人民币48.94元/股。本次发行的初始战略配售发行数量为60.00万股,占发行数量的5.00%。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、企业年金基金和职业年金基金(以下简称“年金基金”)、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简称“保险资金”)与合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值,故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。初始战略配售与最终战略配售的差额60.00万股回拨至网下发行。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为858.00万股,占本次发行数量的71.50%;网上初始发

行数量为342.00万股,占本次发行数量的28.50%。

根据《广东辰奕智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为6,388.79298倍,高于100倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将本次公开发行股票数量的20%(向上取整至500股)的数量,即240.00万股)由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为618.00万股,占本次公开发行股票数量的51.50%;网上最终发行数量为582.00万股,占本次公开发行股票数量的48.50%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.0266365555%,有效申购倍数为3,754.23918倍。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2023年12月21日(T+2日)结束。具体情况如下:

一、新股认购情况统计

保荐人(主承销商)根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)战略配售情况

本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金与合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值,故保荐人相关子公司不参与跟投。本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。最终,本次发行不向战略投资者定向配售。

(二)网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):5,747,900

2、网上投资者缴款认购的股份数量(股):281,302,226.00

3、网上投资者放弃认购数量(股):72,100

4、网上投资者放弃认购金额(元):3,528,574.00

(三)网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):6,180,000

2、网下投资者缴款认购的金额(元):302,449,200.00

3、网下投资者放弃认购数量(股):0

4、网下投资者放弃认购金额(元):0.00

二、网下比例限售情况

网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为621,224股,约占网下发行总量的10.05%,约占本次公开发行股票总量的5.18%。

三、保荐人(主承销商)包销情况

本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票全部由保荐人(主承销商)包销,本次发行保荐人(主承销商)包销股份的数量为72,100股,包销金额为3,528,574.00元,包销股份的数量约占总发行数量的比例为0.60%。

2023年12月25日(T+4日),保荐人(主承销商)将包销资金与网上投资者和网下投资者缴款认购的资金扣除尚未收

的保荐承销费后划转至发行人,由发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐人(主承销商)指定证券账户。

四、本次发行费用

本次发行费用总额为6,364.01万元,具体明细如下:

(一)审计及费用:100.00万元;承销费用:3,523.68万元;

(二)保荐及验资费用:1,266.04万元;

(三)律师费用:1,000.00万元;

(四)用于本次发行的信息披露费用:424.53万元;

(五)印刷费、发行手续费及其他费用:49.76万元;

注:上述各项费用均不含增值税金额,合计数与各分项数值之和尾数如存在微小差异,为四舍五入尾差造成。发行手续费中包本本次发行的印花税,税基为扣除印花税前的募集资金净额,税率为0.025%。

五、保荐人(主承销商)联系方式

网下、网上投资者对本次公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)联系。具体联系方式如下:保荐人(主承销商):兴业证券股份有限公司

联系人:销售交易业务总部股权资本市场处

联系电话:021-20370806、021-20370808

发行人:广东辰奕智能科技股份有限公司

保荐人(主承销商):兴业证券股份有限公司

2023年12月25日

证券代码:688249 证券简称:晶合集成 公告编号:2023-036

合肥晶合集成电路股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

合肥晶合集成电路股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月22日召开第一届董事会第二十三次会议,第一届董事会第十次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)“收购制造基地厂房及厂房设施”予以结项,并将节余募集资金用于永久补充流动资金的事项。公司监事会、独立董事对本次事项发表了明确的同意意见,保荐人(主承销商)兴业证券股份有限公司对本次事项出具了无异议的核查意见,事项无需提交股东大会审议,现将相关情况公告如下:

一、募投项目的基本情况

经中国证券监督管理委员会于2023年5月9日出具的《关于同意合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市注册批复》(证监许可[2023]854号)同意,公司首次公开发行股票人民币普通股(A股)150,533,789股,每股发行价格19.86元,募集资金总额为9,960,641,044.54元,扣除发行费用236,944,589.63元后,募集资金净额为9,723,516,454.91元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司本次公开发行的资金到位情况进行了审计,并于2023年4月26日出具了《验资报告》(容诚验字[2023]33020099号)。

募集资金净额,公司已按照募集资金专户存储管理,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,具体情况详见2023年5月4日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《晶合集成首次公开发行股票并在科创板上市公告书》。

二、募投项目的基本情况

根据《合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金投资项目具体情况如下:

序号	项目名称	拟使用募集资金金额
1	合肥晶合集成电路先进工艺研发项目	49.00
1.1	后摩尔 CMOS 图像传感器芯片工艺平台研发项目(包含90纳米及80纳米)	6.00
1.2	微控制芯片工艺平台研发项目(包含55纳米和40纳米)	3.50
1.3	40纳米逻辑芯片工艺平台研发项目	15.00
1.4	28纳米逻辑及OLED芯片工艺平台研发项目	24.50
2	收购制造基地厂房及厂房设施	31.00
3	补充流动资金及偿还银行贷款	15.00
合计		95.00

截至2023年6月30日,公司募集资金使用情况详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶合集成2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-017)。

三、募投项目的结项及募集资金使用与节余情况

公司本次发行的募投项目为“收购制造基地厂房及厂房设施”,上述募投项目已于2023年9月收购完成并取得相关产权证书。截至2023年12月15日,募投资金的使用及节余情况如下:

项目/科目	募集资金总额	累计已投入募集资金金额	投入进度(除手续费外)	募集资金账户节余资金余额(募集资金总额-A-B+C)
收购制造基地厂房	31,000,000	276,393.67	68.54	31,214.87

注:“募集资金账户节余资金总额”不包含截至2023年12月15日尚未收到的银行利息收入,实际节余资金以资金转出当日计算的该项目募集资金余额金额为准;上述所披露的尾数差异系四舍五入所致。

四、募集资金节余的主要原因

1、募投项目提前结项的原因:公司严格按照募集资金使用的相关规定,在保障质量和进度的前提下,本着务实、合理、有效及节俭的原则谨慎使用募集资金,严格把控收购环节和付款进度,合理降低项目相关成本和费用。

2、2023年8月27日,公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过《关于变更上市募投项目的议案》,公司拟使用31亿元募集资金用于收购制造基地厂房及厂房设施,收购资产的评价价值为32.2亿元,考虑到同期时间较长、资产成新率降低的因素,公司和合肥晶合集成电路股份有限公司(以下简称“合肥晶合”)共同委托安徽中联国信资产评估有限责任公司于2023年4月30日评估基准日出具了《拟转让资产涉及的相关资产及土地使用权评估项目资产评估报告》(中联国信评报字[2023]第189号),对合肥晶合拟收购的资产的市场价值进行了重新评估,评估结论为:评估价值为27.05亿元,最终以评估价值确定合同价款含税27.64亿元。截至目前,该募投项目已收购完成并取得相关产权证书,形成了募集资金节余。

3、为提高募集资金的使用效率,在保障不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益,同时募集资金账户的闲置也产生了一定的投资收益。

五、节余募集资金的使用计划

鉴于上述募投项目已收购完成并取得相关产权证书,为提高募集资金的使用效率,提升公司的经营效益,公司将募投项目“收购制造基地厂房及厂房设施”的节余资金34,214.87元(截至2023年12月15日,含扣除银行利息的收入及理财收益,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。

该募投项目节余资金专用于两个募集资金专户:

序号	开户主体	开户行	银行账号
1	合肥晶合集成电路股份有限公司	中国建设银行股份有限公司合肥支行	340801477880002018
2	合肥晶合集成电路股份有限公司	中国工商银行股份有限公司合肥四牌楼支行	132001011292039569

持有上述募集资金转出后,上述在中国工商银行合肥四牌楼支行开立的募集资金专户将不再使用,公司将注销该募集资金专户,公司所有存款账户、开户银行等募集资金专户信息均予以变更,在中国工商银行合肥四牌楼支行开立的募集资金专户由于上述“收购制造基地厂房及厂房设施”项目及其他募集资金专户,公司将保留该募集资金专户,继续用于公司募集资金存储及使用。

资金存储及使用。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

经审核,我们认为“收购制造基地”厂房及厂房设施”项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,有利于进一步提高募集资金使用效率,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《募集资金管理制度》的规定,符合公司及全体股东的利益,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上所述,我们一致同意公司“收购制造基地”厂房及厂房设施”项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

(二)监事会意见

公司募投项目“收购制造基地”厂房及厂房设施”已收购完成并取得相关产权证书,同意将该项目予以结项,并将节余募集资金用于永久补充流动资金的事项,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《募集资金管理制度》的规定,有利于进一步提高上市公司主营业务现金流,提高募集资金使用效率,降低财务成本,提高盈利能力,符合公司及全体股东的利益,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

(三)保荐机构意见

公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过并符合相关规定,独立董事发表了明确的同意意见,履行了必要的审议程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《募集资金管理制度》的规定,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。

综上所述,保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

合肥晶合集成电路股份有限公司董事会
2023年12月25日

证券代码:688249 证券简称:晶合集成 公告编号:2023-038

合肥晶合集成电路股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

合肥晶合集成电路股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十三次会议于2023年12月22日以书面方式召开,全体董事一致同意豁免本次会议提前90日通知的期限要求,公司于2023年12月22日以书面方式召开全体董事发出召开本次会议的通知,与会的各位董事均已知悉并同意事项的必要性。本次会议应参加本次会议会议的监事9名,实际参加本次会议会议的监事9名。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

同意公司使用募集资金、自有资金及自筹资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份用于股权激励(A股)回购。回购股份将在未来适宜时全部用于股权激励,回购的股份不超过人民币2.56亿元(含),具体回购价格按公司管理层在回购实施期间结合公司实际情况,综合考虑回购股份回购价格、回购资金总额不低于人民币50,000万元(含),不超过人民币100,000万元(含),具体回购资金总额不超过回购期间累计实际回购使用的资金总额为准。回购期限为自股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。同时,董事会同意提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理本次回购股份的相关事宜。

独立董事对本次议案发表了明确的同意意见。

表决结果:9票赞成,占全体监事人数的100%。0票弃权,0票反对。

本次会议尚需提交股东大会审议。

本次会议内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《晶合集成关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》(公告编号:2023-037)。

(二)审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意公司将募集资金投资项目“收购制造基地厂房及厂房设施”予以结项,并将节余募集资金永久补充流动资金。

独立董事对本次议案发表了明确的同意意见。

表决结果:9票赞成,占全体监事人数的100%。0票弃权,0票反对。

本次会议尚需提交股东大会审议。

本次会议内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《晶合集成关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-036)。

特此公告。

合肥晶合集成电路股份有限公司董事会
2023年12月25日

证券代码:688249 证券简称:晶合集成 公告编号:2023-039

合肥晶合集成电路股份有限公司第一届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

合肥晶合集成电路股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十次会议于2023年12月22日以书面方式召开,全体监事一致同意豁免本次会议提前90日通知的期限要求,公司于2023年12月18日以电子邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通知,与会的各位监事均已知悉并同意事项的必要性。本次会议应参加本次会议会议的监事9名,实际参加本次会议会议的监事9名。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意公司将募集资金投资项目“收购制造基地”厂房及厂房设施”已收购完成并取得相关产权证书,同意将该项目予以结项,并将节余募集资金用于永久补充流动资金的事项,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《募集资金管理制度》的规定,有利于进一步提高上市公司主营业务现金流,提高募集资金使用效率,降低财务成本,提高盈利能力,符合公司及全体股东利益,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上所述,我们一致同意公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

表决结果:3票赞成,占全体监事人数的100%。0票弃权,0票反对。

本次会议内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《晶合集成关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-036)。

特此公告。

证券代码:688249 证券简称:晶合集成 公告编号:2023-040

合肥晶合集成电路股份有限公司关于回购股份的公告

合肥晶合集成电路股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月22日召开第一届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司以募集资金、自有资金及自筹资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份用于股权激励(A股)回购。回购股份将在未来适宜时全部用于股权激励,回购的股份不超过人民币2.56亿元(含),具体回购价格按公司管理层在回购实施期间结合公司实际情况,综合考虑回购股份回购价格、回购资金总额不低于人民币50,000万元(含),不超过人民币100,000万元(含),具体回购资金总额不超过回购期间累计实际回购使用的资金总额为准。回购期限为自股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。同时,董事会同意提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理本次回购股份的相关事宜。

独立董事对本次议案发表了明确的同意意见。

表决结果:9票赞成,占全体监事人数的100%。0票弃权,0票反对。

本次会议尚需提交股东大会审议。

本次会议内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《晶合集成关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》(公告编号:2023-037)。

(二)审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意公司将募集资金投资项目“收购制造基地厂房及厂房设施”予以结项,并将节余募集资金永久补充流动资金。

独立董事对本次议案发表了明确的同意意见。

表决结果:9票赞成,占全体监事人数的100%。0票弃权,0票反对。

本次会议尚需提交股东大会审议。

本次会议内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《晶合集成关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-036)。

特此公告。

证券代码:688249 证券简称:晶合集成 公告编号:2023-041

合肥晶合集成电路股份有限公司关于回购股份的公告

合肥晶合集成电路股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月22日召开第一届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司以募集资金、自有资金及自筹资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份用于股权激励(A股)回购。回购股份将在未来适宜时全部用于股权激励,回购的股份不超过人民币2.56亿元(含),具体回购价格按公司管理层在回购实施期间结合公司实际情况,综合考虑回购股份回购价格、回购资金总额不低于人民币50,000万元(含),不超过人民币100,000万元(含),具体回购资金总额不超过回购期间累计实际回购使用的资金总额为准。回购期限为自股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。同时,董事会同意提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理本次回购股份的相关事宜。

独立董事对本次议案发表了明确的同意意见。

表决结果:9票赞成,占全体监事人数的100%。0票弃权,0票反对。

本次会议尚需提交股东大会审议。

本次会议内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《晶合集成关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》(公告编号:2023-037)。

(二)审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意公司将募集资金投资项目“收购制造基地厂房及厂房设施”予以结项,并将节余募集资金永久补充流动资金。

独立董事对本次议案发表了明确的同意意见。

表决结果:9票赞成,占全体监事人数的100%。0票弃权,0票反对。

本次会议尚需提交股东大会审议。

本次会议内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《晶合集成关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-036)。

特此公告。

证券代码:688249 证券简称:晶合集成 公告编号:2023-042

合肥晶合集成电路股份有限公司关于回购股份的公告

合肥晶合集成电路股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月22日召开第一届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司以募集资金、自有资金及自筹资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份用于股权激励(A股)回购。回购股份将在未来适宜时全部用于股权激励,回购的股份不超过人民币2.56亿元(含),具体回购价格按公司管理层在回购实施期间结合公司实际情况,综合考虑回购股份回购价格、回购资金总额不低于人民币50,000万元(含),不超过人民币100,000万元(含),具体回购资金总额不超过回购期间累计实际回购使用的资金总额为准。回购期限为自股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。同时,董事会同意提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理本次回购股份的相关事宜。

独立董事对本次议案发表了明确的同意意见。

表决结果:9票赞成,占全体监事人数的100%。0票弃权,0票反对。

本次会议尚需提交股东大会审议。

本次会议内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《晶合集成关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》(公告编号:2023-037)。

(二)审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意公司将募集资金投资项目“收购制造基地厂房及厂房设施”予以结项,并将节余募集资金永久补充流动资金。

独立董事对本次议案发表了明确的同意意见。

表决结果:9票赞成,占全体监事人数的100%。0票弃权,0票反对。

本次会议尚需提交股东大会审议。

本次会议内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《晶合集成关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-036)。

特此公告。

证券代码:688249 证券简称:晶合集成 公告编号:2023-043

合肥晶合集成电路股份有限公司关于回购股份的公告

合肥晶合集成电路股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月22日召开第一届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司以募集资金、自有资金及自筹资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份用于股权激励(A股)回购。回购股份将在未来适宜时全部用于股权激励,回购的股份不超过人民币2.56亿元(含),具体回购价格按公司管理层在回购实施期间结合公司实际情况,综合考虑回购股份回购价格、回购资金总额不低于人民币50,000万元(含),不超过人民币100,000万元(含),具体回购资金总额不超过回购期间累计实际回购使用的资金总额为准。回购期限为自股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。同时,董事会同意提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理本次回购股份的相关事宜。

独立董事对本次议案发表了明确的同意意见。

表决结果:9票赞成,占全体监事人数的100%。0票弃权,0票反对。

本次会议尚需提交股东大会审议。

本次会议内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《晶合集成关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》(公告编号:2023-037)。

(二)审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意公司将募集资金投资项目“收购制造基地厂房及厂房设施”予以结项,并将节余募集资金永久补充流动资金。

独立董事对本次议案发表了明确的同意意见。

表决结果:9票赞成,占全体监事人数的100%。0票弃权,0票反对。

本次会议尚需提交股东大会审议。

本次会议内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《晶合集成关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-036)。

特此公告。

证券代码:688249 证券简称:晶合集成 公告编号:2023-044

合肥晶合集成电路股份有限公司关于回购股份的公告

合肥晶合集成电路股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月22日召开第一届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司以募集资金、自有资金及自筹资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份用于股权激励(A股)回购。回购股份将在未来适宜时全部用于股权激励,回购的股份不超过人民币2.56亿元(含),具体回购价格按公司管理层在回购实施期间结合公司实际情况,综合考虑回购股份回购价格、回购资金总额不低于人民币50,000万元(含),不超过人民币100,000万元(含),具体回购资金总额不超过回购期间累计实际回购使用的资金总额为准。回购期限为自股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。同时,董事会同意提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理本次回购股份的相关事宜。

独立董事对本次议案发表了明确的同意意见。

表决结果:9票赞成,占全体监事人数的100%。0票弃权,0票反对。

本次会议尚需提交股东大会审议。

本次会议内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《晶合集成关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》(公告编号:2023-037)。

(二)审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意公司将募集资金投资项目“收购制造基地厂房及厂房设施”予以结项,并将节余募集资金永久补充流动资金。

独立董事对本次议案发表了明确的同意意见。

表决结果:9票赞成,占全体监事人数的100%。0票弃权,0票反对。

本次会议尚需提交股东大会审议。

本次会议内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《晶合集成关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-036)。

特此公告。

证券代码:688249 证券简称:晶合集成 公告编号:2023-045

合肥晶合集成电路股份有限公司关于回购股份的公告

合肥晶合集成电路股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月22日召开第一届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司以募集资金、自有资金及自筹资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份用于股权激励(A股)回购。回购股份将在未来适宜时全部用于股权激励,回购的股份不超过人民币2.56亿元(含),具体回购价格按公司管理层在回购实施期间结合公司实际情况,综合考虑回购股份回购价格、回购资金总额不低于人民币50,000万元(含),不超过人民币100,000万元(含),具体回购资金总额不超过回购期间累计实际回购使用的资金总额为准。回购期限为自股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。同时,董事会同意提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理本次回购股份的相关事宜。

独立董事对本次议案发表了明确的同意意见。

表决结果:9票赞成,占全体监事人数的100%。0票弃权,0票反对。

本次会议尚需提交股东大会审议。

本次会议内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《晶合集成关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》(公告编号:2023-037)。

(二)审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意公司将募集资金投资项目“收购制造基地厂房及厂房设施”予以结项,并将节余募集资金永久补充流动资金。

独立董事对本次议案发表了明确的同意意见。

表决结果:9票赞成,占全体监事人数的100%。0票弃权,0票反对。

本次会议尚需提交股东大会审议。

本次会议内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《晶合集成关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-036)。

特此公告。

证券代码:688249 证券简称:晶合集成 公告编号:2023-046

合肥晶合集成电路股份有限公司关于回购股份的公告

合肥晶合集成电路股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月22日召开第一届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司以募集资金、自有资金及自筹资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份用于股权激励(A股)回购。回购股份将在未来适宜时全部用于股权激励,回购的股份不超过人民币2.56亿元(含),具体回购价格按公司管理层在回购实施期间结合公司实际情况,综合考虑回购股份回购价格、回购资金总额不低于人民币50,000万元(含),不超过人民币100,000万元(含),具体回购资金总额不超过回购期间累计实际回购使用的资金总额为准。回购期限为自股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。同时,董事会同意提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理本次回购股份的相关事宜。

独立董事对本次议案发表了明确的同意意见。

表决结果:9票赞成,占全体监事人数的100%。0票弃权,0票反对。

本次会议尚需提交股东大会审议。

本次会议内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《晶合集成关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》(公告编号:2023-037)。

(二)审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意公司将募集资金投资项目“收购制造基地厂房及厂房设施”予以结项,并将节余募集资金永久补充流动资金。

独立董事对本次议案发表了明确的同意意见。

表决结果:9票赞成,占全体监事人数的100%。0票弃权,0票反对。

本次会议尚需提交股东大会审议。

本次会议内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《晶合集成关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-036)。

特此公告。

特此公告。

合肥晶合集成电路股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的公告

合肥晶合集成电路股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月22日召开第一届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司以募集资金、自有资金及自筹资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份用于股权激励(A股)回购。回购股份将在未来适宜时全部用于股权激励,回购的股份不超过人民币2.56亿元(含),具体回购价格按公司管理层在回购实施期间结合公司实际情况,综合考虑回购股份回购价格、回购资金总额不低于人民币50,000万元(含),不超过人民币100,000万元(含),具体回购资金总额不超过回购期间累计实际回购使用的资金总额为准。回购期限为自股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。同时,董事会同意提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理本次回购股份的相关事宜。

独立董事对本次议案发表了明确的同意意见。

表决结果:9票赞成,占全体监事人数的100%。0票弃权,0票反对。

本次会议尚需提交股东大会审议。

本次会议内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《晶合集成关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》(公告编号:2023-037)。

(二)审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意公司将募集资金投资项目“收购制造基地厂房及厂房设施”予以结项,并将节余募集资金永久补充流动资金。

独立董事对本次议案发表了明确的同意意见。

表决结果:9票赞成,占全体监事人数的100%。0票弃权,0票反对。

本次会议尚需提交股东大会审议。

本次会议内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《晶合集成关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-036)。

特此公告。

证券代码:688249 证券简称:晶合集成 公告编号:2023-037

合肥晶合集成电路股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的公告

合肥晶合集成电路股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月22日召开第一届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司以募集资金、自有资金及自筹资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份用于股权激励(A股)回购。回购股份将在未来适宜时全部用于股权激励,回购的股份不超过人民币2.56亿元(含),具体回购价格按公司管理层在回购实施期间结合公司实际情况,综合考虑回购股份回购价格、回购资金总额不低于人民币50,000万元(含),不超过人民币100,000万元(含),具体回购资金总额不超过回购期间累计实际回购使用的资金总额为准。回购期限为自股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。同时,董事会同意提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理本次回购股份的相关事宜。

独立董事对本次议案发表了明确的同意意见。

表决结果:9票赞成,占全体监事人数的100%。0票弃权,0票反对。

本次会议尚需提交股东大会审议。

本次会议内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《晶合集成关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》(公告编号:2023-037)。

(二)审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意公司将募集资金投资项目“收购制造基地厂房及厂房设施”予以结项,并将节余募集资金永久补充流动资金。

独立董事对本次议案发表了明确的同意意见。

表决结果:9票赞成,占全体监事人数的100%。0票弃权,0票反对。

本次会议尚需提交股东大会审议。

本次会议内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《晶合集成关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-036)。

特此公告。